

特种工程材料 电气电子解决方案

用于3D立体电路、移动终端 及5G基站天线应用的 EDGETEK™ LDS配方



在飞速发展的电信行业,5G(第五代蜂窝网络技术)即将全面普及,与此同时,全新基础设施的快速部署也将带动5G基站天线的市场需求。普立万可提供与激光直接成型或3D立体电路工艺兼容的材料,以提高设计灵活性并加快基站天线的上市速度。

Edgetek™ LDS及3D立体电路配方使客户能够在有限空间内实现选择性金属化电路设计。此种材料有助于提高设计灵活性,尤其是在3D天线设计和复杂形状方面。另外还可提供具有高耐热性的定制配方,可与电路板生产的SMT(表面贴装技术)兼容。而且,我们的材料可以在短短几周内供货,从而有助于缩短交货周期,加快产品上市。

EDGETEK™ LDS 系列产品:

基础树脂	产品牌号	基础树脂	Dk	Df	焊接能力
LCP	ET9600-8010 LDS BK001	LCP	4	0.006	280+
	ET9600-8015 3D BK001	LCP	3.9	0.004	270+
	ET9600-8018 3D BK001	LCP	3.44	0.004	250+
	ET9600-8022 3D BK001	LCP	3.06	0.004	250+
PPE	ET7600-8047 3D NC001	PPE	2.6	0.002	No (SMT)
	ET7600-8052 3D NC001	PPE	4.5	0.004	No (SMT)
	ET7600-8040 3D RS NC001	PPE	6	0.002	No (SMT)
	ET7600-8043 3D RS NC001	PPE	9	0.004	No (SMT)
PC	ET3200-8205 3D BK001	PC	2.95	0.006	No (SMT)
	ET3200-8207 3D BK001	PC	2.95	0.006	No (SMT)
	ET3200-8198 3D BK001	PC	3.2	0.006	No (SMT)



普立万EDGETEK LDS及3D立体电路配方在5G基站天线应用方面具有以下优势：

- **提高设计灵活性** – 有助于提高设计灵活性, 尤其是在电路设计、3D天线设计和复杂形状方面
- **加快设计确认效率, 缩短交货周期** – 可根据特定的Dk值进行定制, 并在数周内交付
- **灵活的设计空间** – 有助于优化受空间限制的电路设计
- **与SMT工艺兼容** – 可提供具有耐热性的定制配方, 抗热变形温度范围为200°C-278°C



如需了解更多详情, 请访问 www.avient.com
或致电 +86 021 60294888

www.avient.com



版权所有©2020埃万特公司。对于本文件中所含信息就其在特定应用的准确性、适用性、以及通过使用这些信息而获取或可能获取的结果, 埃万特不做任何表示、保证和担保。某些信息来自使用小型设备的实验室测试, 可能无法可靠指明使用大型设备时获得的表现和性能。“典型”数值或未给出范围的数值不能代表最低或最高性能; 关于性能范围和规格范围信息, 请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件给出的数值。埃万特对于埃万特的产品或者用于贵司工艺或者终端应用的信息的实用性不做任何担保或保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试, 以确定产品是否适用于您的应用工艺, 同时您还需承担因使用这些资料和/或处理任何产品导致的任何风险和责任。对于这些资料或资料中所提及的产品, 埃万特不做出任何明示或暗示的保证, 包括但不限于对特定用途的适销性和合适性的暗示保证。未经专利所有者许可, 本数据表不得作为使用任何专利发明的许可、建议和诱因。